

高导电率大功率H20E导电银胶

产品名称	高导电率大功率H20E导电银胶
公司名称	深圳金雷德机电有限公司
价格	面议
规格参数	材质:大功率银胶 用途:EPO-TEK银胶
公司地址	深圳市宝安区龙华街道和平路东侧梓润馨居一期 A区A2栋508（办公场所）
联系电话	13510797206

产品详情

优质美国h20e高导热大功率led导电银胶

产品规格：

epoxy technology 产品 h20e 主要应用:

填充银环氧树脂胶;是微电子/光电子行业芯片粘接的理想材料.用于快速芯片粘接,jedec level / 塑料芯片封装,高功率/高电流器件及高功率leds应用,光电子行业lcds/leds和光纤器件的封装;由于它高导热性,还广泛用于散热工艺;美国宇航局认可,无毒性,符合usp class vi生物标准.

大功率led专用导电银胶，双组份，无需冷藏，方便运输\操作，室温寿命长，导热29w，适应1-3w大功率led用，是目前应用最为广泛的大功率导电胶，产地美国。

epo-tek h20e是一种双组分，100%固体银填充环氧树脂系统导电胶/银胶，专门用于粘接芯片在微电子，二极管和光电子应用。由于其高导热性，epo-tek h20e也是广泛用于热管理应用程序。多年来的实践证明他依然是导电胶粘剂使用领域中的最佳选择，h20e已证明它是非常可靠。h20e还可以是一个单一的组成部分被冻结在点胶管中。

优点：可以室温下存储；混合后可以保持长达2.5天的有效使用周期；低温下也可以迅速固化；混合比例为1:1,便于操作；优异的导热（29w/mk）和导电(电阻<=0.0004ohm-cm)性能；

本产品的加工定制是否，材质是大功率银胶，用途是EPO-TEK银胶，AB双组份银胶是导电胶黏剂